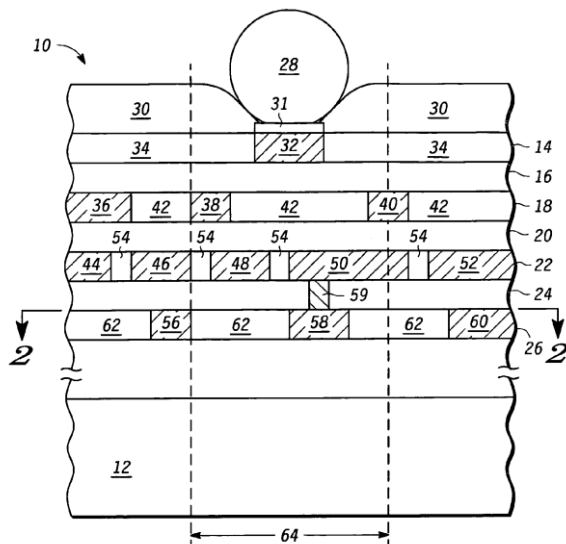


本件特許の図1～図3 (主要要素の名称の注釈付き)



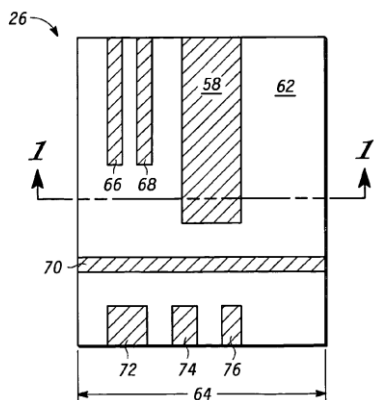
10 : 集積回路

12 : 基板

18, 22, 26 : 相互接続層

16, 20, 24 : 層間誘電体

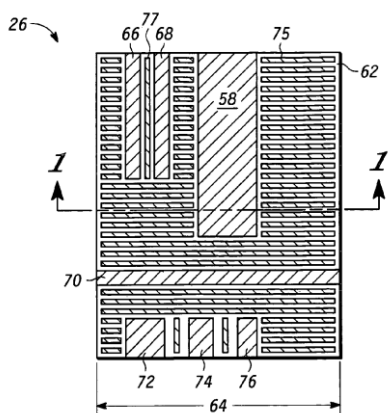
FIG. 1



64 : 力領域

58, 66, 68, 72, 74, 76:金属線

FIG. 2



75, 77 : ダミー金属線

FIG. 3